

证券代码：688603

证券简称：天承科技

广东天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参会单位	申万宏源证券、山西证券、华金证券、长城证券、华安证券、中银证券、中金公司、中信证券、平安证券、安信证券、兴业证券、民生证券、睿郡资产、太平资产、合远基金、国泰基金、五地投资、瑞华控股、兆天投资、鹏扬基金、中欧基金、财通资管、阿杏投资、广发资管、申万菱基金、东方基金、华夏基金、长江证券、元禾璞华	
调研时间	2024年1月22日（周一）14:00-15:00 2024年1月24日（周三）8:30-15:00	
会议地点	公司子公司会议室	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：费维 证券事务代表：邹镛骏	
投资者关系活动主要内容记录	<p>（一）请问贵金属硫酸钯价格下降对于公司的年收入和水平沉铜产品毛利率的影响大吗？</p> <p>答复：</p> <p>公司水平沉铜产品的结算单价与其主要原材料硫酸钯相对应的国际钯价联动，且水平沉铜产品占公司整体销售收入的比例较大，进而对公司销售额造成影响。由于公司优化配方，通过降低活化剂钯单耗、提升使用寿命的方式降本增效，降低了原材料硫酸价格波动对于水平沉铜产品毛利率的影响。</p> <p>（二）2023年天承在PCB电镀添加剂的销售量相比2022年有增加吗，如何看待电镀添加剂国产化率提升速度？</p>	

	<p>答复：</p> <p>2023 年公司电镀产品的销售量较上一年明显增加。目前国内 PCB 电镀添加剂的国产化率较低，电镀是公司重点发展的方向，公司的不溶性阳极直流和脉冲体系的产品，是真正能带动行业智能化发展的产品。随着技术的不断积累和沉淀，更多客户的认可，天承逐步扩大 PCB 电镀添加剂产品销量，加速 PCB 电镀添加剂国产化率的提升。</p> <p>（三）ABF 载板的沉铜和电镀未来放量的节奏如何？</p> <p>答复：</p> <p>国内当前 ABF 生产工厂投入比较大的内资企业是深南电路、兴森科技以及珠海越亚，但其放量大小主要取决于下游的进度。另外，外资方面，天承也在同步接洽，包括奥特斯、群策等载板企业。但上述台资或欧美体系载板企业的终端客户认证进度与周期相对较长。</p> <p>公司看好 2024 年 ABF 载板的放量进度，但具体增长的速度难以预测。我们认为，总体格局已形成，机会已经出现。</p> <p>（四）公司上海工厂二期关于半导体封装的厂房建设进展如何？</p> <p>答复：</p> <p>上海工厂二期半导体项目建设进度已接近完工阶段，计划于 2024 年上半年实现投产，并陆续开展客户验证、产品放量阶段。</p> <p>（五）请问公司先进封装的电子化学品主要布局情况？</p> <p>答复：</p> <p>公司先进封装部分目前主要聚焦在 RDL 和 bumping, 其应用的基础液和电镀添加剂已经研发完成。其中，RDL 应用的基础液和电镀添加剂已经进入了终端客户最终验证阶段。此外，公司正全力推动 TSV 相关的基础液和电镀添加剂产品研发进程，同时大马士革电镀液也正处于积极研发的过程中。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 1 月 30 日